

2025

华润微电子有限公司

“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告

华润微电子有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告

华润微电子有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本、高质量发展”的理念，结合公司战略发展规划及业务实际，于 2025 年 4 月 30 日发布《华润微电子有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司致力于通过稳健经营、规范治理、积极回报股东等措施，切实履行上市公司责任，夯实长期投资价值根基。2025 年上半年，在行动方案及整体战略指引下，各项举措扎实落地、成效显著。现将上半年具体执行情况与成果报告如下：

一、坚持 IDM 商业模式，以高质量发展铸就价值投资基础

2025 年上半年，受益于汽车电子、光伏、储能及消费电子等市场平稳增长，公司持续强化产品核心竞争力，优化客户结构，多个新产品成功导入核心客户，在国内市场已形成品牌影响力。

报告期内，公司实现营业收入 52.18 亿元，同比增长 9.62%；其中，二季度实现营业收入 28.63 亿元，同比增长 8.28%，环比增长 21.61%。报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润 3.39 亿元，较上年同期增长 20.85%；其中，二季度实现归属于母公司所有者的净利润 2.56 亿元，同比增长 3.42%，环比增长 207.12%。营收、净利同环比均呈现稳健增长态势，发展质量持续提升。

公司持续加大重点项目建设，着力提升整体产品能力与制

造工艺水平，为长期业务增长提供强劲动能，实现“质”与“量”的同步跃升。重点项目进展如下：

1. 重庆 12 吋功率半导体晶圆生产线项目

项目充分发挥产线技术先进性，聚焦新能源汽车主驱、车载充电机等核心应用场景，车规级 IGBT、SGT MOS、超结 MOS 等产品工艺性能对标业界一流水平，产能利用率稳步提升，为公司高端功率器件业务发展奠定坚实基础。

2. 深圳 12 吋集成电路生产线项目

项目产能建设按规划稳步推进，同步加速 90nm、55nm 以及 40nm 平台工艺开发及产品导入进程。充分利用 IDM 模式优势，加快 8 吋升级 12 吋策略，构建规模化基础业务能力。同时，重点聚焦行业头部客户、细分市场龙头以及高潜力客户，构建优质客户储备池。

3. 先进功率封测基地

项目聚焦汽车电子和工业控制等高端市场应用需求，已形成模块级封装、晶圆级封装、功率器件框架级封装、面板级封装等工艺布局，有效配套并有力支撑公司 12 吋功率半导体产品及第三代半导体产品的封装需求。

4. 高端掩模项目

项目聚焦掩模高阶产品，持续提升研发与制造能力。技术方面，90nm 掩模已实现规模量产，同时稳步推进 55nm 研发能力；产出方面，技术节点 0.18um 以下产品产出数量同比提升 22%，在高等级产品占比逐步提升的情况下，掩模新品良率始终保持在 98%以上，准时交付率近 100%。

二、加快发展新质生产力，聚焦技术和产品创新

公司围绕应用场景不断拓宽产品布局，持续推出有市场竞争力的产品。报告期内，核心产品线均实现快速增长，充分发挥 IDM 模式下多元化产品矩阵的协同效应。

1. 推动研发投入稳步增长

公司坚持高研发投入驱动创新与成果转化。报告期内研发投入达到 5.48 亿元，占营业收入比重达 10.50%。期内新增申请专利 111 项，新增获得专利授权 80 项。截至报告期末，公司累计申请专利 6,085 项，累计获得专利 2,419 项，其中发明专利占比 85%，构筑公司核心技术护城河。

2. 加速产品技术迭代

公司多项产品性能与工艺居于国内领先地位，与国际先进水平的差距持续缩小。其中：

（1）MOSFET 产品：

中低压 MOSFET：中低压 SGT 产品重点布局汽车与工业控制领域，最新代次 G6 产品凭借优异参数特性，已在汽车电子关键应用场景实现批量交付；推出 TO、TOLT、DFN 等新型封装解决方案，为产业发展及客户价值提升注入强劲动力，保障业绩持续增长。

高压 MOSFET：超结 MOS 最新一代多层外延 G4 平台性能比肩国际主流技术水平，快速推进产品系列化，覆盖汽车电子、工业控制和消费电子多领域；MSOP、TOLL、QDPAK 等新型封装产品在汽车 OBC、充电桩、服务器电源等领域的多家客户完成测评进入量产。

（2）IGBT 产品：

报告期内，IGBT 产品在工业控制（含光伏）、汽车电子领域销售占比超过 70%。基于 8 吋平台开发的高压 G5 系列产品，在光储、家电、电动工具、伺服变频等领域大批量供货；车规产品批量稳定供应至汽车电子动力总成、热管理、OBC 等领域头部客户及 Tier1 厂家。基于 12 吋线成功开发 G7 产品，性能对标国际一流水平，已在光储客户实现批量供货，产品竞争力显著提升。

（3）第三代宽禁带半导体：

报告期内，碳化硅和氮化镓功率器件销售收入同比实现高速增长。

碳化硅产品，SiC JBS G3 和 SiC MOS G2 完成产品系列化并量产，整体产品性能达到国际领先水平，围绕新能源汽车、充电桩、光储逆变、数据中心电源、工业电源等领域全面推广上量。围绕 OBC、DC-DC、车载空压机、主驱逆变的多款车规级 SiC MOS 和模块均已出样并在行业头部客户测试认证和量产导入。同时，SiC MOS G3、G4 平台同步研发中，目前已开始 G4 平台产品系列化，以应对高效率应用场景的需求。

氮化镓产品，D-MODE 平台产品有序迭代，产品系列进一步丰富，产品 RSP 水平持续提升，中高压平台 6 颗产品开发制版中，高压平台产品有望在今年年底下线；E-MODE 平台建设及产品研发取得突破性进展。

（4）模块产品：

公司功率产品模块化成效显著，IGBT 模块、IPM 模块、TMBS

模块、MOSFET 模块、SiC 模块整体规模同比增长 70%。其中，车规级 IGBT 模块进入批量生产阶段；IPM 模块实现工业市场重点突破，在变频器、工业泵等领域头部客户实现大批量供货，同时在伺服控制领域顺利通过标杆客户验证；SiC 模块的 HPD、DCM、MSOP 等多个车规及工规模块产品市场拓展取得显著进展，在汽车电子、光伏逆变、工业电源、充电桩等领域实现销售，同时在算力电源领域也取得实质性进展。

(5) 功率 IC、智能传感器及智能控制产品：

功率 IC 产品依托 12 吋工艺实现了中大功率驱动产品系列化，并成功导入头部客户供应链；智能传感器产品在家电、工控等领域实现规模化量产；MCU 产品通过差异化设计，覆盖家电、工控、汽车等多维应用场景，抗量子计算安全 MCU 凭借创新方案驱动销售，实现批量交付。

3. 推动下游应用向高端转型

公司产品与方案板块下游终端应用主要围绕四大领域，其中泛新能源领域（车类及新能源）占比 44%，消费电子领域占比 38%，工业设备占比 9%，通信设备占比 9%。

公司围绕人工智能领域深度布局。端侧 AI 应用重点聚焦消费电子（如 AI 手机、AI PC）以及汽车电子的电动化与智能化转型，并积极拓展至工业及人形机器人、工业自动化等场景。云端 AI 应用致力于为服务器电源提供高性能功率器件解决方案。此外，公司积极拓展智能驾驶、低空经济、数据中心等新兴领域，为公司带来多元化增量空间。

三、以奋斗者为本，深入实施人才强企战略

公司持续深化人才队伍建设，激发员工积极性与创造性，为战略实施提供核心动能。

1. 高端人才引进与培养

公司紧密围绕战略规划及重点项目需求，持续加大功率器件产品、传感器等半导体技术领域高端人才引进力度，重点引进高层次技术专家与复合型管理人才；同时，严格落实人才战略规划，深化与国内知名高校的产学研合作，促进研发与产业化深度融合。截至报告期末，公司拥有 11,000 名员工，其中研发技术人员 4,488 名，占比 40.80%。核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，具备前瞻创新能力，有力保障公司市场敏锐度、科研水平及产品迭代能力，满足客户终端产品的创新需求。

2. 强化考核评价

公司持续优化考核评价体系与收入分配机制，激发人才活力。积极报批上市公司股权激励二期计划，旨在建立长效激励机制，实现员工与企业共同成长。此外，公司通过不断优化组织架构、完善绩效管理体系，有效提升管理水平与组织活力。

四、以投资者为本，与投资者共享发展成果

公司始终坚持稳定、持续、可预期的现金分红政策，积极回馈股东。2025 年 6 月 12 日，公司顺利完成 2024 年度现金分红，派息率达 10%，切实兑现回报承诺。值得关注的是，公司将于 2025 年半年度报告期后首次实施中期分红，进一步强化股东回报的及时性。

2025 年 4 月，为积极响应国家关于提升上市公司质量与加

强市值管理的政策导向，公司基于提升内在价值，制定并颁布实施了《华润微电子有限公司市值管理制度》，旨在通过系统性举措提升公司投资价值并持续增强投资者回报。

五、完善公司治理，以卓越董事会实现高效管理

1. 秉持“高标准、严要求”规范并实现高质量信息披露

2025年上半年，公司严格遵守监管要求，共披露公告文件47份。通过提升信息披露的深度、广度与时效性，有效传递公司价值，保障透明度。公司在上海证券交易所2022至2024连续两个年度科创板信息披露工作评价中，均获“A”级评价。

2. 完善公司治理制度

2025年1月，公司股东会审议通过了修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度。新增《董事长行使董事会授权工作规则》，系统梳理并更新了《董事会授权决策事项清单》，明确授权范围与决策流程，确保授权合理、运行高效。同时，完成决策事项清单与权责运行手册的修订工作，进一步规范公司治理运作。

3. 强化外部董事和独立董事履职

公司积极为董事履职创造良好条件。2025年上半年，外部董事人均履职45个工作日；独立董事人均履职24个工作日。公司有效组织董事参与股东会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，重要议题提前充分交流；邀请董事出席战略经营会、业绩说明会、中期检讨会等关键会议；组织董事参加行业及上市公司专业培训，定期传递行业动态及公司经营信息。此外，公司积极安排董事调研下属单位并与管理层深入座

谈，为董事会科学决策和公司高质量发展提供专业支撑。

4. 持续落实经理层向董事会报告机制

2025年4月，公司召开2024年年度董事会，公司董事长代行总裁职责作《2024年年度总裁工作报告》，并向董事会报告了董事会授权决策事项的行权情况。

2025年5月，公司有序完成董事会换届衔接，保障治理机制平稳过渡与战略决策连续性，持续强化董事会战略督导与经理层执行效能的双向协同。

六、合规严谨做好投关管理，多措并举提高上市公司质量

公司高度重视投资者关系管理工作，坚持“透明、专业、及时、有效”的沟通原则，多渠道、多形式加强与资本市场的互动，有效传递公司投资价值。

1. 高质量召开业绩说明会

公司将业绩说明会视为公司价值传递的重要平台。2025年4月30日，公司召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会，公司董事长、董事会秘书出席会议并向百余家机构及个人投资者深度解读业绩及经营成果。

2. 强化投资者互动

公司通过策略会、路演、反向路演、接待机构调研等多种途径，主动保持与投资者的高频次、深层次沟通。重点对接国内大型保险资管、养老基金等长期机构投资者及国际主流投资机构。

3. 完善沟通渠道

公司高效响应投资者关切，通过官方网站投资者关系专栏、

社交媒体官方账号、投资者热线及电子邮箱等渠道，加深投资者对公司经营发展的了解，增强认同感与市场信心。报告期内，通过“上证 e 互动”平台答复投资者提问 34 次，答复率 100%。

七、全面贯彻“ESG”理念，坚定执行“双碳”战略

公司充分认识到 ESG 工作对于可持续发展和长期价值创造的重要性，将 ESG 理念全面融入运营与战略决策中：

1. ESG 管理提升

公司连续 12 年编制发布可持续发展报告/社会责任报告，2025 年首次获得中国企业社会责任报告评级专家委员会“五星级卓越报告”评价。公司及下属单位连续两年编制“1+N”系列可持续发展报告（1 份上市公司报告+4 份下属单位可持续发展报告），深化子公司 ESG 管理意识，挖掘更全面 ESG 信息，显著提升披露深度与广度。

2. 评级及荣誉认可

公司 ESG 表现获得市场高度认可，报告期内获国内知名 ESG 评级机构 Wind“AA 级”评价，位列同类行业第二。同时，成功入选国务院国资委“央企 ESG·先锋 100 指数”、央视“中国 ESG 上市公司·长三角先锋 50”以及“中国 ESG 上市公司·科创 30”榜单；连续两年位列中国社科院课题组发布的半导体行业社会责任发展指数第四名。

3. 行业引领与贡献

公司联合半导体优秀企业、权威评级机构及专业中介机构，共同参与并推动《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）之半导体行业》的编纂、发布及推广实施，为行业可持续发展

贡献了行动路径与参考案例。此外，公司积极参与香港品质保证局发起的气候相关财务影响指南编写工作，分享行业经验。

4. ESG 品牌建设

公司系统规划并推进五大 ESG 行动方向，包括绿色低碳、以人为本、科技创新、携手共赢、暖芯行动，全方位履行企业社会责任。响应国家乡村振兴战略，在消费助农基础上，持续夯实服务乡村建设的可持续举措。

5. 供应链管理

公司作为发起单位之一，积极参与中国供应商 ESG 评级平台建设。发布《负责任矿物采购声明》，要求供应商签署并遵守“无冲突矿产”条款，共同维护劳工权益、信息安全与环境标准，推动产业链可持续发展。

6. 信息披露创新与框架优化

公司参照上海证券交易所《上市公司自律监管指引——可持续发展报告》编制 2024 年度可持续发展报告。积极探索并实践“双重重要性”ESG 管理思路，即“对公司财务的重要性”和“对经济、社会和环境的影响的重要性”。试点采用包含“治理、战略、影响风险和机遇管理、指标与目标”的四支柱披露框架，并加强了本地化 ESG 指标的披露。

本公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到外部经济环境、行业市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。